

徒然なるままに・・・

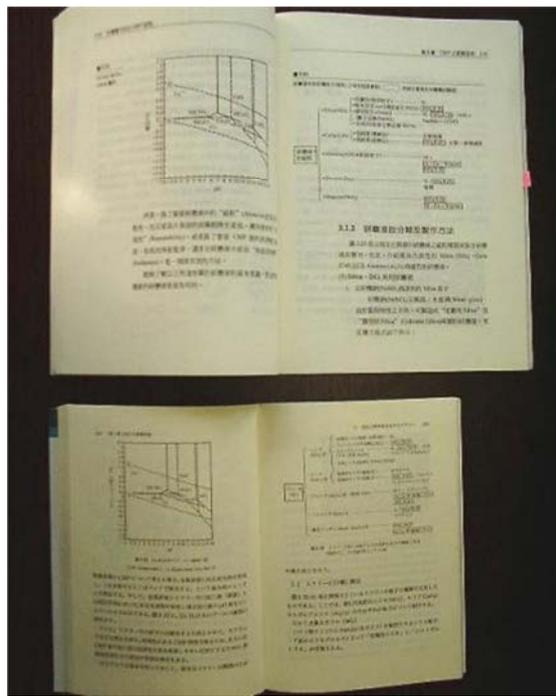
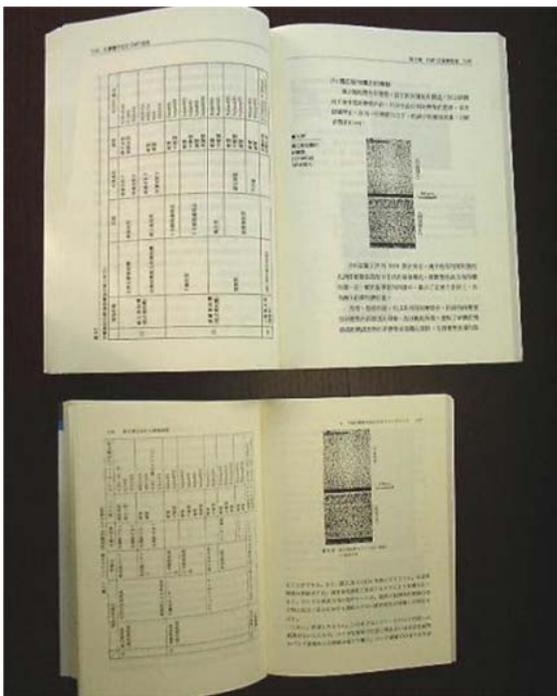
- 海賊版単行本『半導体平坦化CMP』 -

埼玉大学 土肥 俊郎

先月、台湾に行く機会を得た。台湾のある学会からの招待講演であったが、3時間の講演のためにだけいくのはちょっともったいない、どこか企業等を訪問しようかと考えていた。しかし、忙しさにまぎれてとうとう出発を明日に控えるになってしまったそんな矢先、台北にある大きな砥石メーカーのH社長から電話があった。子会社として”シリコンウエハの加工会社”を設立したので、是非案内したいとのことであった。こんなにタイミングよく電話があるとは、何か幸先がよい。

台湾に着いた翌日、早速会社を懇切丁寧に案内していただいた。そこは、研削を前加工に採用し、エッチング工程を省き、トコトン省力化して新しいプロセスを確立した、8"と12"ウエハの加工工場(クリーンルーム)であった。2~3年前に設立し、月産数10万枚の加工規模を誇る。加工プロセスの短縮化及び自動検査装置をふんだんに導入したすばらしい工場であった。

見学させてもらい、会議室で打ち合わせも済ませ、のんびりした気分で談笑していると、「土肥先生のCMPの本、台湾でも非常に評判が良く、売れていますよ。」という。ホホー、日本語で読まれているのかと関心したのも束の間、「これですよ」と差し出された本(写真参照)を見ると、中国語に翻訳されているではないか。



さて、翻訳出版の許可を出したっけ？

と思いをめぐらしながら、その本をぱらぱらとめくってみると中味の図面・表・写真は全く同じ。なのに、小生の名前が何処にも載っていない。表紙などに書かれた名前は、中国名の3名の”御名前”に変わっている。翻訳者と推察するが、・・・・・・。

さて、帰国してからその海賊版のことを、出版社(工業調査会)のI氏に電話で伝えた。I氏曰く「本当ですか？ やっぱね。人気のある本ほどそういう海賊版が出回り、結局は泣き寝入りなんですよ」電話の向こうから小生のがっかりした声を聞いたI氏、再び曰く、「いや、海外で認められていることですから、喜んで良いのですよ」。

・・・・・謝辞

